

News Release

2022年1月25日

株式会社日立ソリューションズ・テクノロジー

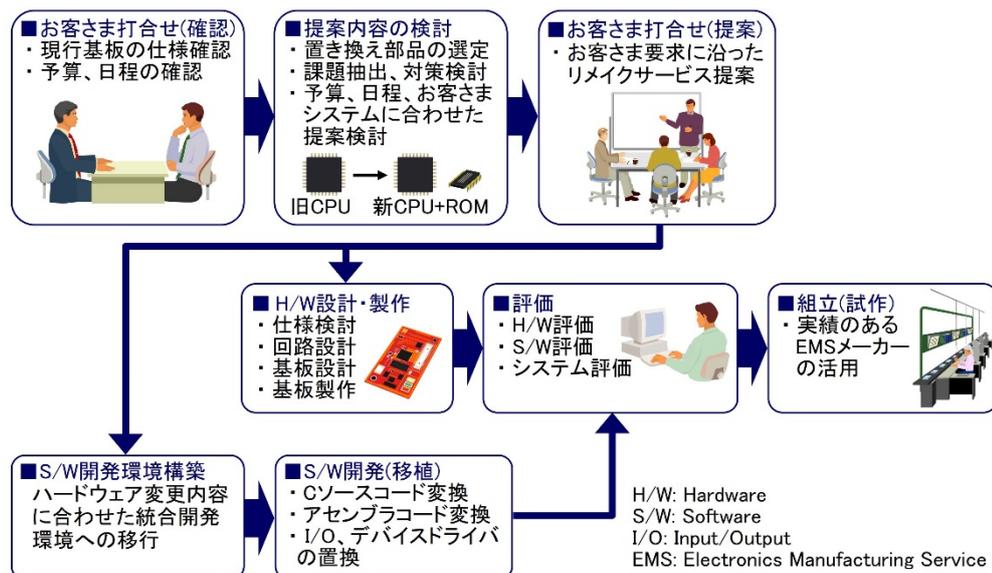
半導体不足による製造課題を解決する「基板リメイクサービス」の提供を開始

入手困難な部品から入手性の良い部品への基板リメイク開発を支援

株式会社日立ソリューションズ・テクノロジー（本社：東京都立川市、取締役社長：森山 隆志、以下、日立ソリューションズ・テクノロジー）は、世界的な半導体不足による入手困難な部品を入手性の良い部品へ置き換える「基板リメイクサービス」を1月25日より提供開始します。

昨今のパンデミックや自然災害、事故などに起因する世界的な半導体不足により、納期調整や市場流通部品の活用だけでは製品の継続生産が困難になっています。特にCPUやFPGA^(*)などの高機能部品は単純な置き換えでは対応できず、深刻な状況になっています。このような状況を回避するため、多くのお客さまが入手性の良い部品への置き換えによる製品の継続生産を検討し始めています。しかしながら、半導体部品は、種類や機能が多種多様であるため、代替部品の選定や、回路修正、ソフトウェアの変更などが難しく、専門性と経験が必要になります。日立ソリューションズ・テクノロジーは、「基板リメイクサービス」により、長年にわたるハードウェア・ソフトウェア開発およびデバイス設計の経験を持つ技術者が最適な代替方法を提案することにより、お客さまの課題解決を支援します。

「基板リメイクサービス」では、旧基板に対する変更対象の仕様明確化から、FPGAの論理設計や基板開発・評価を含むハードウェアの置き換え、また、ソフトウェアのポーティング作業や開発環境の移行などを各工程単位で提供します。本サービスを通じて、すべての工程をワンストップで当社にお任せいただくことにより、お客さまの管理工数の低減を可能にします。



基板リメイクサービスの流れ

© 株式会社 日立ソリューションズ・テクノロジー

本社 〒190-0014 東京都立川市緑町7番地1

Tel:042-512-0888(代表)

<https://www.hitachi-solutions-tech.co.jp/>

日立ソリューションズ・テクノロジー

■ 「基板リメイクサービス」の特長

- ・設計者が不在、仕様書が無い場合でも旧基板の仕様の明確化が可能
- ・製品仕様や市場の流通性を考慮した入手性の良い最適な置き換え部品の提案が可能
- ・当社開発プロセスまたはお客さま開発プロセスでの設計開発・妥当性検証による設計品質を確保
- ・ハードウェア、ソフトウェア開発が当社単独で対応できるためお客さまの管理工数低減が可能

■ 「基板リメイクサービス」メニュー

サービスメニュー		設計概要
仕様明確化作業		旧基板に対する変更対象の仕様明確化
ハードウェア 置き換え作業	部品変更検討	CPU、ロジック、FPGA（論理開発含む）置き換え検討
	新基板開発	仕様書作成、追加仕様検討、構成検討、回路設計、基板設計（シミュレーション含む）、試作製造、機能検証
	基板評価	CPU・ソフト置き換えを含めたシステム評価および信頼性などの性能検証
ソフトウェア 置き換え作業	ドライバソフト移植	変更基板に対応した API ^{(*)2} 互換ドライバ開発
	アプリソフト移植	システム仕様を考慮し、アプリケーション機能を維持した移植・評価
	OS 移植	システムおよび変更後のハードウェアに合わせた最適な OS のポーティング
	開発環境の移行	ハードウェア変更内容に合わせた開発環境の移行

*1 Field Programmable Gate Array

*2 Application Programming Interface

日立ソリューションズ・テクノロジーは今後も、先端の組込みシステム技術を活用したシステムソリューションを提供することで、お客さま製品の安定供給や事業継続を支えてまいります。

■ 「基板リメイクサービス」

<https://www.hitachi-solutions-tech.co.jp/embedded/solution/hard/remake/index.html>

■ お問い合わせ先

株式会社日立ソリューションズ・テクノロジー

〒190-0014 東京都立川市緑町7番地1

URL：<https://www.hitachi-solutions-tech.co.jp/>

製品・サービスに関するお問い合わせ先

<https://www8.hitachi.co.jp/inquiry/hitachi-solutions-tech/products/jp/form.jsp>

報道機関お問い合わせ先

経営企画部 [担当：山田] 電話：042-512-0821（直通）

以上

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
